

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

公告编号：2025-064

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS-OCS 通过验证并启动试产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）OCS（Optical Circuit Switch 的缩写，即光链路交换器件）通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS-OCS 8 英寸晶圆的小批量试生产。

该 MEMS-OCS 基于 8 英寸 MEMS 工艺和设计技术制造，结构复杂精密，是一组由指定数量平面镜所构成的微镜阵列，可用于精确调节光链路的折射方向，实现光链路之间的信号切换与双向传播，提高运算系统的整体性能及稳定性，同时降低系统成本与功耗，可在数据中心网络、超算系统集群等场景中得到广泛应用。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件晶圆的生产诀窍，努力为通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司以“Pure-Foundry（纯芯片代工制造厂商）”模式在本土形成和提升自主可控的 MEMS 工艺开发及晶圆制造能力，加速国产替代进程。

根据产业发展规律及公司此前境内外产线的实际运营经验，不同类别 MEMS 芯片一般都需要经历从工艺开发到风险试产、规模量产的过程，所耗时间存在客观差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日